

請求の範囲

- [請求項1] 基材層と、前記基材層の第1面側に設けられ、かつ、電子部品を仮固定するための粘着性樹脂層（A）と、前記基材層の第2面側に設けられ、かつ、外部刺激により粘着力が低下する粘着性樹脂層（B）と、を備える粘着性フィルムと、
- 前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層（A）に貼り付けられた電子部品と、
- 前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層（B）に貼り付けられた支持基板と、を備える構造体を準備する工程（1）と、
- 前記粘着性フィルム中の水分量を低下させる工程（2-1）および前記構造体中の水分量を低下させる工程（2-2）から選択される少なくとも一種の工程（2）と、
- 封止材により前記電子部品を封止する工程（3）と、
- を少なくとも備える電子装置の製造方法。
- [請求項2] 請求項1に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記工程（2）は、前記粘着性フィルム中の水分量を低下させる工程（2-1）を含み、
- 前記工程（2-1）は、前記工程（1）の前におこなう電子装置の製造方法。
- [請求項3] 請求項2に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記工程（2-1）では、前記粘着性フィルムを加熱する、および／または、前記粘着性フィルムを減圧することによって、前記粘着性フィルム中の水分量を低下させる電子装置の製造方法。
- [請求項4] 請求項1に記載の電子装置の製造方法において、
- 前記工程（2）は、前記構造体中の水分量を低下させる工程（2-2）を含み、
- 前記工程（2-2）は、前記工程（1）と前記工程（3）の間におこなう電子装置の製造方法。

- [請求項5] 請求項4に記載の電子装置の製造方法において、
前記工程（2－2）では、前記構造体を加熱する、および／または、前記構造体を減圧することによって、前記構造体中の水分量を低下させる電子装置の製造方法。
- [請求項6] 請求項4または5に記載の電子装置の製造方法において、
前記工程（2）は、前記工程（3）の直前におこなう電子装置の製造方法。
- [請求項7] 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記工程（3）の後に、外部刺激を与えることにより前記粘着性樹脂層（B）の粘着力を低下させて前記構造体から前記支持基板を剥離する工程（4）をさらに備える電子装置の製造方法。
- [請求項8] 請求項7に記載の電子装置の製造方法において、
前記工程（4）の後に、前記電子部品から前記粘着性フィルムを剥離する工程（5）をさらに備える電子装置の製造方法。
- [請求項9] 請求項1乃至8のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記工程（2）と前記工程（3）との間隔は12時間以内である電子装置の製造方法。
- [請求項10] 請求項1乃至9のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記封止材がエポキシ樹脂系封止材である電子装置の製造方法。
- [請求項11] 請求項1乃至10のいずれか一項に記載の電子装置の製造方法において、
前記粘着性樹脂層（A）は（メタ）アクリル系粘着性樹脂を含む電子装置の製造方法。